



本社：〒160-8366
東京都新宿区西新宿 6 丁目 24 番 1 号
西新宿三井ビルディング

報告書番号：PCN#20091117002B
2011 年 8 月 23 日

お客様各位

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
営業・技術本部 カスタムドキュメント
マネージャ 牧 達郎 (牧)

ASP nFBGAパッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更のご案内
(認定済 201 製品への追加認定 2 製品の連絡)

(第三版 PCN20091117002A 2011 年 6 月 9 日発行)

(第二版 PCN20091117002 2010 年 12 月 14 日発行, 初版 PCN20091117002 2009 年 11 月 20 日発行)

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお喜び申し上げます。平素は弊社製品のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、標題の件につきましてご連絡させていただきます。ご査収の程、宜しく願い申し上げます。

今回のお知らせは、変更実施についての追加連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではございません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはございません。

お客様におかれましては、本通知発行日後、**30** 日以内に通知確認のご連絡をお願いいたします。また、変更前の製品サンプル作製は行わない為、変更品評価用サンプルご入用の場合には、事前に本通知発行日後 30 日以内にご依頼をお願いいたします。変更時期につきましては、次頁以降の変更時期をご参照下さい。お客様の受領連絡及びサンプル依頼は PCN 担当マネージャ或いは担当営業にご連絡下さい。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **90** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。

尚、変更時期につきましては、在庫状況により異なりますので、担当営業にお問い合わせ下さい。また、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いはpcn_tij@list.ti.comにお問い合わせ下さい。

以上

変更概要

通知タイプ	☐ Initial notice (Plan)	☒ Final notice		
変更概要	Design/Specification	☐ Design	☐ Electrical	☐ Mechanical
	Wafer Fab	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	Wafer Bump	☐ Site	☐ Process	☐ Material
	☒ Assembly	☐ Site	☐ Process	☒ Material
	Test	☐ Site	☐ Process	
	Others	☐ Packing/Shipping/Labeling	☐ -	
変更内容	下記変更について認定済 201 製品への追加認定 2 製品の連絡になります。 ASP nFBGA パッケージ 一部製品 Cu(銅)線ボンディングワイア変更 現行 : Au(金)線 ボンディングワイア 変更後 : Cu(銅)線 ボンディングワイア			
対象製品	対象製品リスト参照			
変更時期	追加認定品は 12 月上旬の出荷より予定しています。 (追加認定品サンプルは 9 月下旬の出荷より予定しています。) 認定終了品は 2010 年 1 月下旬の出荷より実施しています。			
品質認定試験	☐ 計画	☒ 終了		
製品表示	☒ 変更無し	☐ 変更あり		
備考	—			

変更内容

内容：今回のお知らせは、下記変更について認定済201製品への追加認定2製品の連絡になります。
弊社 ASP(アプリケーションスペシフィックプロダクト) nFBGAパッケージ 一部製品について、現行 Au(金)線 ボンディングワイアを使用して製造していますが、ボンディングワイアの機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為に、これに替えて、Cu(銅)線 ボンディングワイアへ移行し認定しました。尚、今回の変更で、製品についての互換性(寸法/公差), 外観, 動作特性, 品質, 信頼性への影響はありません。

変更内容
ボンディングワイア

現行
Au(金)線

変更後
Cu(銅)線

理由：機械/電気的特性の向上及び同種製品の組立技術推移に対応する為

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

対象製品リスト

対象製品名

■:追加認定品 □:認定終了品

C6421SURFVOZWT4	DM6441ZWTARCH	M6441AZWTHAIERIN	M6446AZWTSKYWORTH	TMS320C6424ZWT7
C6421SURFVOZWT4B	DM6441ZWTARCL	M6441AZWHTSPHI	M6446AZWTTONGLI	TMS320C6424ZWT6
C6421SURFVOZWT5	DM6441ZWTBEK	M6441AZWTIFLYTECH	M6446ZWTAVMEAWOX	TMS320DH6435ZWT6
C6421SURFVOZWT5B	DM6441ZWT TMSN	M6441AZWTMICRO	M6446ZWTAVMEHIMEDI	TMS320DH6443ZWT
C6421SURFVOZWT6	DM6443ADB6C3126MP	M6441AZWTPM	M6446ZWTAVMEMOTO	TMS320DH6446ZWT
C6421SURFVOZWT6B	DM6443DB6C3125MP	M6441AZWTSEED	M6446ZWTHAIERIN	TMS320DM335CZCE135
C6424SURFVDZWT4	DM6446AAB6C4130VD	M6441PMPZWTING	M6446ZWTHAERSF	TMS320DM335CZCE216
C6424SURFVDZWT4B	DM6446ANB6C2127VC	M6441PNDZWTING	M6446ZWTHISENSE	TMS320DM335CZCE270
C6424SURFVDZWT5	DM6446APB6C6128ED	M6441PTVZWTING	M6446ZWTJUIZHOU	TMS320DM335ZCE135
C6424SURFVDZWT5B	DM6446AZWTKEDACOM	M6441ZWTHAIERIN	M6446ZWTRINCOTEX	TMS320DM335ZCE216
C6424SURFVDZWT6	DM6446EB6C2110VS	M6441ZWT SREU	M6446ZWTSKYWOTH	TMS320DM335ZCE270
C6424SURFVDZWT6B	DM6446GB6C0121MV	M6443AZWTBJSF	M6446ZWT SREU	TMS320DM335ZCEA135
C6424SURFVOZWT4	DM6446HB6C0114VC	M6443AZWTHAIER	M6446ZWTSTYLE	TMS320DM335ZCEA216
C6424SURFVOZWT4B	DM6446IB6C0107VS	M6443AZWTKAITIAN	M6446ZWTSYS	TMS320DM350HAZWK
C6424SURFVOZWT5	DM6446IB6C4112VS	M6443AZWTPM	M6446ZWTVRISMO	TMS320DM350HZWK
C6424SURFVOZWT5B	DM6446LB6C3108VS	M6443ZWTARTIES	M6446ZWTVTAILYN	TMS320DM350HZWK
C6424SURFVOZWT6	DM6446LB6C3109VS	M6443ZWTAMI	M6447ZWTAVMEMOTO	TMS320DM350LAZWK
C6424SURFVOZWT6B	DM6446M1CD1C2104SC	M6443ZWTAVMEAWOX	M6447ZWTAWX	TMS320DM350LZWK
DM335SZCE135	DM6446MLTD1C2105ST	M6443ZWTAVMEHIMEDI	M6447ZWTLEADTEK	TMS320DM350UHZWK
DM335SZCE216	DM6446NB6C5123NP	M6443ZWTAVMEKONKA	M6447ZWTTIME	TMS320DM350ULZWK
DM335SZCE270	DM6446RB6C6122VP	M6443ZWTAVMEMEDIAE	SN3490586	TMS320DM355CZCE135
DM335ZCE135TYCO	DM6446RB6C6124VP	M6443ZWTAVMEYUXING	TMS320C5504AZCH10	TMS320DM355CZCE216
DM350HZWK-ACM	DM6446SB6C6117MD	M6443ZWTAVMEZTE	TMS320C5504AZCH12	TMS320DM355CZCE270
DM350HZWK-KD17	DM6446ZB6C3111VP	M6443ZWTING	TMS320C5504AZCHA10	TMS320DM355CZCE27J
DM350HZWK-KD53	DM644NECED1C2102VC	M6443ZWTJET	TMS320C5504AZCHA12	TMS320DM355CZCEA13
DM350HZWKMINOTON	F761516ZAV	M6443ZWTVERISMO	TMS320C5505AZCH10	TMS320DM355CZCEA21
DM350LZWKAB	F761541AZVLR	M6443ZWTVTAILYN	TMS320C5505AZCH12	TMS320DM355DZCE135
DM350LZWK-ACM	F761586DZCKR	M6443ZWTWNC	TMS320C5505AZCHA10	TMS320DM355DZCE216
DM350LZWKAO	F761586EZCKR	M6444AZWTRAVM	TMS320C5505AZCHA12	TMS320DM355DZCE270
DM350LZWKMINOTON	F761586GZCKR	M6444AZWTAIRTIES	TMS320C5515AZCH10	TMS320DM355ZCE135
DM350LZWKPHIL	M350ZWKDPFING	M6444AZWTAMI	TMS320C5515AZCH12	TMS320DM355ZCE216
DM350UHZWKHD	M355ZCE216BSTSP	M6444ZWTAMI	TMS320C5515AZCHA12	TMS320DM355ZCE270
DM350ULZWKMINOTON	M355ZCE216CCTV	M6444ZWTAVM	TMS320C5SGCHA	TMS320DM355ZCEA135
DM355SZCE135	M355ZCE216JABIL	M6444ZWTTIME	TMS320C6421ZWT4	TMS320DM355ZCEA216
DM355SZCE216	M355ZCE216NEXTAR	M6446AZWTBESTA	TMS320C6421ZWT5	TMS320DM357ZWT
DM355SZCE270	M355ZCE216WPGSF	M6446AZWTBJSF	TMS320C6421ZWT6	TMS320DM6431ZWT3
DM355SZCEA135	M355ZCE270BSTSP	M6446AZWTHAIER	TMS320C6421ZWT7	TMS320MED355ZCE216
DM355SZCEA216	M355ZCE270QUADRANT	M6446AZWTHAIERIN	TMS320C6421ZWT6	TMS320VC5504ZCH
DM355ZCE216DTEG	M355ZCE270WPGSF	M6446AZWTHISENSE	TMS320C6424ZWT4	TMS320VC5505ZCH
DM355ZCE216ECH	M6435CZWTSLG	M6446AZWTPAV	TMS320C6424ZWT5	
DM6437ZWT6-IOIMAGE	M6441AZWTBJSF	M6446AZWTPM	TMS320C6424ZWT6	

日本テキサス・インスツルメンツ株式会社

信頼性試験

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009 年 11 月 15 日	終了	2010 年 8 月 29 日		
信頼性試験 - 試料構成詳細						
Qual Device:	X6567G4NN0ZWKR	Die Size (mm2):	99.47, 28.83			
Wafer Fab:	DMOS6 / SMIC, UMC12A / DMOS6	Wafer Technology:	1218C027.26NOW, 1218C027.05NOW			
Assembly Site:	TIPI	Package/Code/Pins:	nFBGA/ZWK/385			
Die Attach:	84-3MV	Mold Compound:	KMC 3580T			
Bond Wire:	0.8 mils Dia., Cu	Solder Ball Composition:	SnAgCu			
Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	-	-			
信頼性試験結果						
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails				
		Lot #1	Lot #2	Lot #3	Lot #4	Lot #5
**THB	85C/85%RH, 600HRS	13/0	13/0	13/0	13/0	13/0
**UHASt	110C/85%RH, 264HRS	39/0	39/0	39/0	39/0	39/0
**Temperature Cycle	-55/125C, 1000CYC	39/0	39/0	39/0	39/0	39/0
**Storage Bake	150C, 600HRS	39/0	39/0	39/0	39/0	39/0
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C						

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009 年 11 月 15 日	終了	2010 年 8 月 29 日
信頼性試験 - 試料構成詳細				
Qual Device:	F761516ZAV	-	-	
Wafer Fab:	DMOS6	Wafer Technology:	1218C027.05	
Assembly Site:	TIPI	Package/Code/Pins:	nFBGA/ZAV/289	
Die Attach:	Hitachi 84-3MV	Mold Compound:	Shinetsu KMC-3580LTV	
Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	-	-	
信頼性試験結果				
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails		
		Lot #1	Lot #2	Lot #3
Temperature Cycle	-55/125C, 1000CYC	90/0	90/0	90/0
Manufacturability	per mfg. Site specification	501/0	506/0	503/0
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C				

信頼性試験結果

信頼性試験期間	開始	2009 年 11 月 15 日	終了	2010 年 8 月 29 日			
信頼性試験 - 試料構成詳細							
Qual Device:	F761541AZVLR	-	-				
Wafer Fab:	DMOS6	Wafer Technology:	1218C027.06				
Assembly Site:	TIPI	Package/Code/Pins:	nFBGA/ZVL/354				
Die Attach:	Hitachi 84-3MV	Mold Compound:	Shinetsu KMC-3580T				
Moisture Level:	JEDEC L-3/260C	-	-				
信頼性試験結果							
Reliability Test	Condition / Duration	Sample Size/ Fails					
		Lot#1	Lot#2	Lot#3	Lot#4	Lot#5	Lot#6
**THB	85C/85%RH, 1000HRS	40/0	29/0	42/0	40/0	39/0	39/0
**UHASt	110C/85%RH, 264HRS	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0
**Temperature Cycle	-55/125C, 1000CYC	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0
**Storage Bake	150C, 1000HRS	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0	40/0
Manufacturability	-	Approved					
Notes: ** Test requires Moisture Preconditioning, JEDEC L-3 / 260C							